

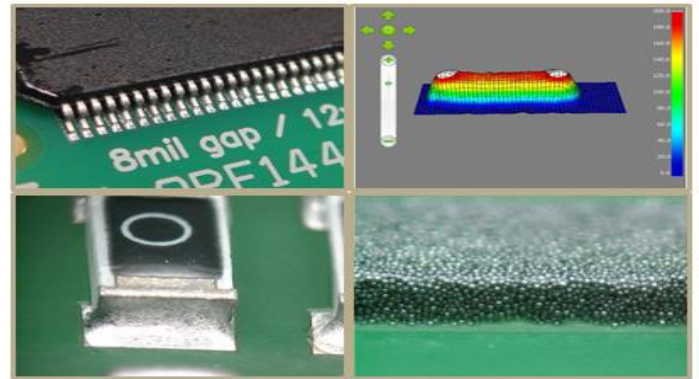
## NC257-2 PASTA NO CLEAN

### CARATTERISTICHE

- Compatibile RoHS
- Esente da alogeni
- Riduce i Voids sotto ai micro-BGA
- Solder beading ridotto
- Eccellente bagnabilità
- Riduce i difetti di Head in Pillow
- Residui testabili con letto d'aghi

### DESCRIZIONE

NC257-2 è stata formulata to offer per garantire ampia finestra di processoper bagnabilità e testabilità con letto d'aghi. NC257-2 produce saldature brillanti, chiare e lisce e residui molto chiari e minimi. NC257-2 è stata sviluppata per reflow in aria, ma può essere usata con azoto e in vapor phase. NC257-2 è concepita per aumentare la performance in serigrafia ed il tack time negli ambienti dotati di controllo temperatura non ottimale.



### MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

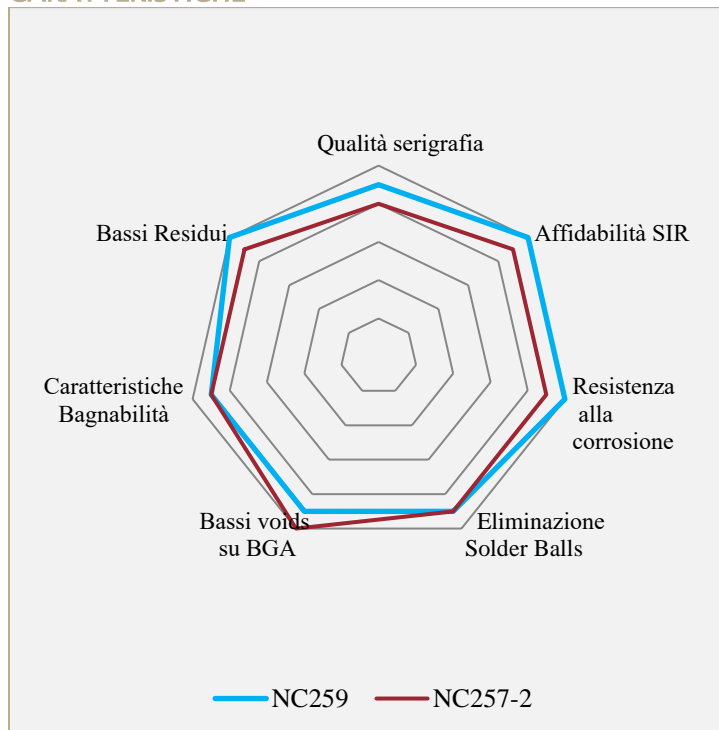
Legga	Parametro	Tempo	Temperatura
Lead-Free	Scadenza refrigerata	1 anno	0°C-12°C (32°F-55°F)
Lead-Free	Scadenza non refrigerata	6 mesi	< 25°C (< 77°F)
Piombo	Scadenza refrigerata	9 mesi	0°C-12°C (32°F-55°F)
Piombo	Scadenza non refrigerata	4 mesi	< 25°C (< 77°F)

Non aggiungere pasta usata alla pasta fresca. Stoccare la pasta usata separatamente; mantenere la pasta non utilizzata rigorosamente chiusa con tappo e controtappo originali. Lega e condizioni di stoccaggio influiscono sulla deperibilità. Riferirsi al Certificato di analisi della NC257-2 per informazioni specifiche sul prodotto

### LAVAGGIO

Prima del reflow: AIM DJAW-10 rimuove efficacemente la pasta NC257-2 dalle lamine durante il processo. DJAW-10 può essere applicato a mano o usato con i sistemi di pulizia sotto alla lamina. DJAW-10 non secca la NC257-2 e migliora la trasferibilità. Non applicare DJAW-10 sulla parte superiore della lamina, L'alcol isopropilico non è raccomandato durante il processo, ma può essere utilizzato come risciacquo finale. rin Residui Post-Reflow: Non è necessario rimuovere i residui di NC257-2. Nel caso fosse obbligatorio il lavaggio contattare AIM, che fornirà una tabella di compatibilità con i maggiori solventi in commercio.

### CARATTERISTICHE




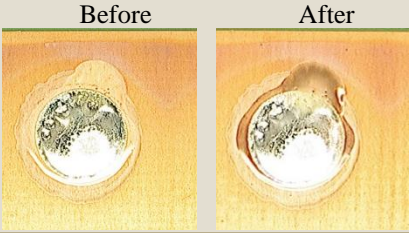

## PROFILO TERMICO

Informazioni dettagliate sul profilo possono essere ricavate <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Contattare AIM per informazioni addizionali


## SERIGRAFIA

Settaggio iniziale delle macchina – Dipendente dal disegno PCB e Pad	
Parametri raccomandati	
Pressione racla	0.4 - 0.7kg/25mm
Velocità racla	13 – 152 mm/secondo
Distanza snap-off	A Contatto 0.00 mm
Distanza di separazione dal PCB	0.75 - 2.0 mm
Velocità di separazione dal PCB	3 - 20 mm/secondo

## RIEPILOGO DATI DEI TEST

Nome	Metodo analisi	Risultati	
Classificazione flusso secondo IPC	J-STD-004	ROLO	
Nome	Metodo analisi	Risultato	Immagine
Copper Mirror	J-STD-004 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BASSA	
Corrosione	J-STD-004 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASSA	
Oxygen Bomb Test alogeni	EN14582:2007 SW 9056 SW 5050	Br 585 mg/Kg Cl < 247 mg/Kg	
Alogeni quantitativos, Silver Chromate	J-STD-004 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASS	
Alogeni qualitativo, Fluoride Spot	J-STD-004 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	PASSA	
SIR	J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASSA	

# TECHNICAL DATA SHEET

Nome	Metodo analisi	Risultati	Immagine
Elettromigrazione	J-STD-004 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1	PASS	
Determinazione valore acido	J-STD-004 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	150 mg KOH/ g flux Typical	
Viscosità	J-STD-004 3.4.2.4 IPC-TM-650 2.4.34	500-900 kcps	
Visivo	J-STD-004 3.4.2.5	Grigio liscio Cremoso	
Slump	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASSA	
Solder Ball	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASSA	
Tack	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	30 gf Tipico	